02P96

タングステン堆積層形成過程における水素透過挙動のモデリング

Modeling of hydrogen permeation behavior during tungsten deposition layer formation

平中芳樹¹、花田和明²、片山一成¹、大宅諒¹ Yoshiki Hiranaka¹, Kazuaki Hanada², Kazunari Katayama¹, Makoto Oya¹

> 1.九大総理工 2.九大応力研 1.IGSES Kyushu Univ. 2.RIAM Kyushu Univ.

1、 緒言

トカマク型核融合炉内では、プラズマ中の高エネルギー燃料粒 子が壁材料(タングステン)を弾き出すスパッタリングが起こる。 スパッタされたタングステン(W)はプラズマ対向壁等に堆積し、 再堆積層を形成する。再堆積層はバルクの壁材料と比べ、トラッ プサイトが多く存在する等、母材とは異なる物性を示す⁽¹⁾。本研 究では、タングステン堆積層を形成しながら水素のプラズマ誘導 透過粒子束を計測し、粒子透過モデルを作成することによって核 融合炉で起こる素過程の物理特性を調べることを目的とした。

2、 実験

高周波電源装置(RF 電源)に W 基板を設置し、グラウンド電 極側に厚さ 20µm の円盤状ニッケル(Ni)基板を設置した。Ni 基 板を透過する水素透過束を四重極型質量分析計(QMS)で測定し た。水素ガス供給量を流量調節計で調節し、真空チャンバー内 の圧力が 10Pa になるよう調節した。水素プラズマによる W 基 板のスパッタリングが生じると W 原子・イオンの一部が、Ni 基板上に堆積層を形成する。そのため、堆積層形成を行いなが ら水素透過束を観測できる。RF 入射電源は 100W である。



Fig.1 プラズマ駆動透過実験装置

3、 実験結果

実験結果を Fig.2 に示す。プラズマ点火後 3500 秒間は水素透 過が大きいことから、プラズマ暴露直後は Ni 基板の透過が支 配的だと考えられる⁽²⁾。ピーク後は定常にならず透過量が減少 している。この結果を理解するために計算との比較を実施し た。計算は、膜厚変化に対応するため TMAP7 で検証した自作 コードで実施した。膜厚・試料温度・入射粒子数一定とし、材 料内での飛程分布は半値幅が 1nm の正規分布として W 堆積層 内のみに付与されることとした。計算部分を表面・内部・W-Ni 境界の3つに分け、試料内部は拡散、試料表面は再結合を仮定 し、両者が接する境界では、

$$D_{w}\left(\frac{\partial Cw}{\partial x}\right)\Big|_{x=x_{B}} = -\nu(C_{w}(x_{B}) - K_{s}C_{ni}(x_{B}))$$
(1)

$$D_{ni}\left(\frac{\partial Cni}{\partial x}\right)\Big|_{x=x_B} = \nu(C_w(x_B) - K_s C_{ni}(x_B))$$
(2)

とした。ここで、 Γ_w , Γ_{ni} は境界面でのWからNiへ、NiからW への水素粒子フラックス、 C_w , C_{ni} はW,Ni中の水素濃度、Dは拡 散係数⁽³⁾で添え字は各材料元素である。 x_B はWとNiの境界 面、vは拡散速度で水素原子の拡散の速さを表す。 K_s はNiに対 するWの粒子束の差で、Wが再堆積層であることの効果が含 まれる。

Fig.2 は自作コードの Ni 基板側の透過束と実験結果を比較した もので、W 表面の再結合係数を段階的に変化させたものであ る。試料温度の変化は考慮していない。計算結果は、立ち上が りの時間変化や後半の透過束の減少を再現することが出来ない 為、膜厚が放電時間とともに変化していることを考慮する必要 があることを示している。今後は膜厚変化を考慮したコードの 開発を行う予定である。



4、 参考文献

¹ Yue Xu, Yoshi Hirooka, Naoko Ashikawa, et al., Fusion Eng.

Des, **125**, (2017), 239.

² 平中芳樹, 九州大学工学部エネルギー科学科卒業論文, Feb,(2019).

³金属データブック,日本金属学会,(2004)